

(12) 특허협력조약에 의하여 공개된 국제출원

(19) 세계지식재산권기구
국제사무국

(43) 국제공개일

2022년 8월 18일 (18.08.2022)



(10) 국제공개번호

WO 2022/173131 A1

- (51) 국제특허분류:
H05K 5/06 (2006.01) H04M 1/02 (2006.01)
H05K 1/14 (2006.01) G06F 1/16 (2006.01)
H05K 5/00 (2006.01)
- (21) 국제출원번호: PCT/KR2022/000347
- (22) 국제출원일: 2022년 1월 10일 (10.01.2022)
- (25) 출원언어: 한국어
- (26) 공개언어: 한국어
- (30) 우선권정보:
10-2021-0019059 2021년 2월 10일 (10.02.2021) KR
- (71) 출원인: 삼성전자 주식회사 (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) [KR/KR]; 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR).
- (72) 발명자: 조성건 (CHO, Sunggun); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 김종근 (KIM,

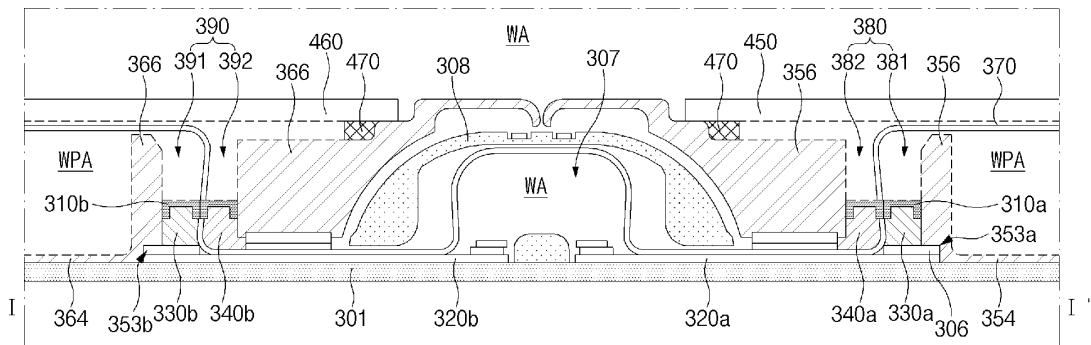
- Jongkeun); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 최원희 (CHOI, Wonhee); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 김재희 (KIM, Jaehye); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 박화목 (PAK, Hwamok); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 안민이 (AN, Minyee); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR). 이동익 (LEE, Dongik); 16677 경기도 수원시 영통구 삼성로 129, Gyeonggi-do (KR).
- (74) 대리인: 특허법인 태평양 (BAE, KIM & LEE IP); 04521 서울시 중구 청계천로 30, 5층, Seoul (KR).
- (81) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 국내 권리의 보호를 위하여): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IR, IS, IT, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KW,

(54) Title: ELECTRONIC DEVICE COMPRISING WATERPROOF STRUCTURE

(54) 발명의 명칭: 방수 구조물을 포함하는 전자 장치

300

310a } 410a 310b } 410b
330a } 330b }
340a } 340b }



(57) Abstract: According to various embodiments of the present disclosure, disclosed is an electronic device comprising: at least one flexible circuit board passing through a first through hole included in a first housing and a second through hole included in a second housing; a first support bracket which supports the flexible circuit board while covering the first through hole; a second support bracket which supports the flexible circuit board while covering the second through hole; a first waterproof member arranged to be oriented from the first support bracket toward a partial region of the first through hole to be inserted into the partial region of the first through hole; a second waterproof member inserted into the remaining regions of the first through hole; a third waterproof member arranged to be oriented from the second support bracket toward a partial region of the second through hole to be inserted into the partial region of the second through hole; and a fourth waterproof member inserted into the remaining regions of the second through hole.

[다음 쪽 계속]

WO 2022/173131 A1

KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, ME, MG, MK, MN, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 지정국 (별도의 표시가 없는 한, 가능한 모든 종류의 역내 권리의 보호를 위하여): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), 유라시아 (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), 유럽 (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

공개:

— 국제조사보고서와 함께 (조약 제21조(3))

(57) 요약서: 본 발명의 다양한 실시 예들에 따르면, 제1 하우징에 포함된 제1 관통홀 및 제2 하우징에 포함된 제2 관통홀을 경유하는 적어도 하나의 연성 회로 기판과; 상기 제1 관통홀을 덮으면서 상기 연성 회로 기판을 지지하는 제1 지지 브라켓과; 상기 제2 관통홀을 덮으면서 상기 연성 회로 기판을 지지하는 제2 지지 브라켓과; 상기 제1 지지 브라켓으로부터 상기 제1 관통홀의 일부 영역을 향하도록 배치되어 상기 제1 관통홀의 일부 영역에 삽입되는 제1 방수 부재와; 상기 제1 관통홀의 나머지 영역에 삽입되는 제2 방수 부재와; 상기 제2 지지 브라켓으로부터 상기 제2 관통홀의 일부 영역을 향하도록 배치되어 상기 제2 관통홀의 일부 영역에 삽입되는 제3 방수 부재와; 상기 제2 관통홀의 나머지 영역에 삽입되는 제4 방수 부재를 포함하는 전자 장치가 개시된다.